

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه تبریز

دانشکده فیزیک

گروه حالت جامد و الکترونیک

پایان نامه

برای دریافت درجهٔ کارشناسی ارشد در رشتهٔ فیزیک

عنوان

بررسی ویژگی‌های الکتریکی لایه‌های نازک نانوساختار (AlTiN) تهییه شده به روش
کندوپاش مگنترونی واکنشی دوگانه (DC و RF) با تغییر شرایط نهشت

استاد راهنما

دکتر مجتبی پرهیزکار - دکتر حسن بیدادی

استاد مشاور

دکتر حمید نقش آرا

پژوهشگر

رضا جلالی

۹۲ شهریور

نام خانوادگی دانشجو: جلالی

نام: رضا

عنوان پایان نامه: بررسی ویژگی های الکتریکی لایه های نازک نانوساختار (AlTiN) تهیه شده به روش کندوپاش مگنترونی واکنشی دوگانه (DC و RF) با تغییر شرایط نهشت

اساتید راهنما: دکتر حسن بیدادی - دکتر مجتبی پرهیز کار

استاد مشاور: دکتر حمید نقش آرا

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد گرایش: حالت جامد و الکترونیک رشته: فیزیک

دانشگاه: تبریز دانشکده: فیزیک تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور ۹۲ تعداد صفحه:

کلید واژه ها: کندوپاش مگنترونی، ثابت هال، رسانندگی، نانوساختار، پروب چهار سوزنی

چکیده:

در این پژوهش، فیلم های نازکی از AlTiN با استفاده از یک سیستم کندوپاش مگنترونی واکنشی بر روی زیر لایه های کوارتزی و سرامیکی، تحت فلوهای متفاوت گاز نیتروژن، دماهای مختلف زیر لایه و همچنین توان های تخلیه الکتریکی مختلف AC و DC تهیه شده و تأثیر این پارامترها بر روی ویژگی های الکتریکی لایه ها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی خواص الکتریکی، از روش پروب چهارسوزنی و نیز اثر هال در دمای اتاق استفاده شد و پارامترهایی مثل مقاومت ویژه، رسانندگی الکتریکی و ثابت هال محاسبه شد.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که با افزایش فلوی گاز نیتروژن، مقاومت الکتریکی و مقاومت ویژه لایه ها افزایش می یابد. این افزایش مقاومت را می توان به دو عامل نسبت داد : با افزایش فلوی گاز نیتروژن، ترکیبات AlN در فیلم، افزایش می یابد با توجه به اینکه AlN ماده ای با گاف انرژی بزرگ است، در حالیکه TiN یک رسانای خوب است در نتیجه افزایش میزان AlN در ترکیب باعث افزایش گاف انرژی ترکیب شده، که این امر باعث افزایش مقاومت الکتریکی لایه می شود و دوم اینکه با افزایش

فلوی نیتروژن، اندازه دانه فیلم‌ها کاهش می‌یابد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که با افزایش دمای زیرلایه، مقاومت الکتریکی لایه‌ها کاهش می‌یابد که این موضوع ناشی از بهبود کیفیت کریستالی فیلم‌ها، در دماهای بالا است. تغییر توان تخلیه الکتریکی نیز بر روی ویژگی‌های الکتریکی لایه‌ها تأثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه در این پژوهش هدف آلومینیومی، به کاتد با جریان AC و هدف تیتانیومی به کاتد با جریان DC متصل می‌شوند، با افزایش توان تخلیه AC میزان کندوپاش اتمهای آلومینیوم افزایش یافته و باعث افزایش میزان AlN در ترکیب لایه می‌شود و به همین ترتیب افزایش توان DC باعث افزایش کندوپاش اتمهای Ti می‌شود و در نتیجه میزان TiN در ترکیب فیلم‌ها افزایش یافته و با توجه به اینکه TiN ماده‌ای با گاف انرژی کوچک است افزایش آن در ترکیب لایه، باعث کاهش مقاومت الکتریکی می‌شود.

۱ فصل اول : بررسی منابع و پیشینه تحقیق

۴ مقدمه (۱-۱)
۴ تعریف لایه نازک (۲-۱)
۵ تقسیم بندی انواع لایه‌ها (۳-۱)
۶ خواص لایه‌های نازک (۴-۱)
۶ (۱-۴-۱) خواص مکانیکی
۸ (۲-۴-۱) خواص الکتریکی
۹ (۳-۴-۱) خواص مغناطیسی
۱۰ (۴-۴-۱) خواص نوری
۱۱ (۵-۴-۱) خواص شیمیایی
۱۱ (۶-۴-۱) خواص حرارتی
۱۲ (۵) مروری بر علم نانو
۱۲ (۱-۵-۱) تعریف نانوفناوری
۱۲ (۲-۵-۱) تعریف نانوماده
۱۳ (۳-۵-۱) نانوساختارها
۱۴ (۴-۵-۱) خواص عمومی نانومواد
۱۴ (۱-۴-۵-۱) افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم
۱۵ (۲-۴-۵-۱) ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتمی
۱۵ (۵-۵-۱) دسته بندی نانو مواد
۱۶ (۶-۵-۱) رفتار الکترونها در نانومواد
۱۷ (۱-۶-۵-۱) نقطه کوانتمی
۱۷ (۲-۶-۵-۱) سیم کوانتمی

۱۸	چاه (چشم) کوانتومی ۳-۶-۵-۱
۱۸	۶-۱) فرایند رشد لایه‌های نازک ۶-۱
۲۱	۱-۶-۱) رشد جزیره‌ای (ولمر-وبر) ۱
۲۱	۱-۶-۱) رشد لایه‌ای (فرانک-واندرمرو) ۱
۲۲	۱-۶-۳) رشد جزیره‌ای - لایه‌ای (استرانسکی - کراستنوف) ۱
۲۴	۱-۶-۴) تنش لایه‌های نازک ۱
۲۴	۷-۱) روش‌های تهیه لایه‌های نازک ۱
۲۵	۱-۷-۱) روش‌های فیزیکی تهیه لایه‌های نازک ۱
۲۵	۱-۷-۱) روش‌های شیمیایی برای ساخت لایه‌های نازک ۱
۲۶	۱-۷-۳) روش‌های فیزیکی - شیمیایی برای ساخت لایه‌های نازک ۱
۲۷	۱-۸) مختصری در مورد فیزیک پلاسمایا ۱
۲۸	۱-۸-۱) تاریخچه کندوپاش پلاسمایی ۱
۲۹	۱-۸-۲) کندوپاش پلاسمایی ۱
۳۰	۱-۸-۳) فرایند کندوپاش ۱
۳۱	۱-۸-۳-۱) ویژگی گاز تزریق شده در فرایند کندوپاش ۱
۳۲	۱-۸-۳-۲) برخوردهای کندوپاش ۱
۳۴	۱-۸-۳-۳) انواع فرایند کندوپاش ۱
۳۴	۱-۸-۳-۳-۱) کندوپاش دیودی (کاتدی) ۱
۳۵	۱-۸-۳-۳-۲) کندوپاش کاتدی سه قطبی (تریودی) ۱
۳۷	۱-۸-۳-۳-۳) کندوپاش مگنترونی ۱
۳۸	۱-۸-۳-۴) ضربی کندوپاش ۱

۲ فصل دوم : مواد و روشها

۴۳	۲-۲) آلمینیوم تیتانیوم نیترید (AlTiN)
۴۵	۱-۲-۲) مزایای پوشش AlTiN بر روی ابزارها
۴۶	۳-۲) کندوپاش مگنترونی
۴۹	۱-۳-۲) انواع فرایندهای کندوپاش مغناطیسی
۴۹	۱-۱-۳-۲) فرایند کندوپاش مغناطیسی DC
۵۰	۲-۱-۳-۲) کندوپاش مگنترونی RF
۵۲	۳-۱-۳-۲) فرایند کندوپاش مغناطیسی دوگانه
۵۲	۴-۱-۳-۲) کندوپاش مگنترونی واکنشی
۵۳	۲-۳-۲) دستگاه کندوپاش مگنترونی و ترتیبات تجربی
۵۳	۱-۲-۳-۲) اجزای دستگاه کندوپاش مگنترونی
۵۵	۲-۲-۳-۲) معرفی سیستم کندوپاش پلاسمایی مگنترونی MECA-2000
۵۸	۴-۲) زیر لایه ها
۵۸	۱-۴-۲) انواع زیرلایه
۵۹	۲-۴-۲) آماده سازی زیرلایه ها
۵۹	۱-۲-۴-۲) روش شیمیایی
۵۹	۲-۲-۴-۲) بطور فراصوتی با استفاده از برخی حلال های شیمیایی
۶۰	۳-۲-۴-۲) روش الکتریکی (بوسیله بمباران یونهای مثبت در تخلیه نورانی)
۶۱	۲-۵-۲) خواص الکتریکی لایه های نازک و روشهای اندازه گیری آنها
۶۱	۱-۵-۲) هدایت الکتریکی
۶۳	۲-۵-۲) مقاومت ویژه
۶۴	۱-۲-۵-۲) نمونه حجمی
۶۵	۲-۲-۵-۲) فیلم نازک
۶۷	۳-۵-۲) تحرک پذیری
۶۷	۴-۵-۲) ثابت هال
۶۹	۵-۵-۲) اندازه گیری ضریب هال، رسانندگی و مقاومت ویژه

۳ فصل سوم : نتایج و بحث

۱-۳) مشخصات لایه‌های نانوساختار تیتانیوم آلمینیوم نیترید تهیه شده با کندوپاش پلاسمایی مگنترونی ۷۵
۲-۳) اندازه‌گیری مقاومت ویژه، رسانندگی و مقاومت الکتریکی فیلم‌های نانوساختار تیتانیوم آلمینیوم نیترید با تغییر شرایط نهشت ۸۱
۱-۲-۳) تغییر فلوی گاز نیتروژن ۸۲
۱-۱-۲-۳) مطالعه اثر تغییر فلوی گاز نیتروژن بر روی مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی لایه‌های TiAlN برای لایه نشانی بر روی زیرلایه‌های در دمای اتاق ۸۳
۲-۱-۲-۳) مطالعه اثر تغییر فلوی گاز نیتروژن بر روی مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی لایه‌های TiAlN برای لایه نشانی بر روی زیرلایه‌های در دمای ۴۰۰ درجه سانتی-گراد ۸۵
۲-۲-۳) تغییر دمای زیرلایه ۸۷
۳-۲-۳) تغییر توان تخلیه الکتریکی ۹۱
۳-۳) اندازه‌گیری ثابت هال در فیلم‌های نانوساختار تیتانیوم آلمینیوم نیترید با تغییر شرایط نهشت ۹۸
۱-۳-۳) آماده سازی لایه‌ها برای کن tact زنی ۹۸
۲-۳-۳) نحوه انجام آزمایش اثر هال بر روی نمونه‌ها ۱۰۰
۳-۳-۳) نتایج بدست آمده برای ثابت هال نمونه‌ها ۱۰۱
۴-۳-۳) بررسی اثر تغییرات فلوی گاز نیتروژن بر روی ثابت هال و چگالی حامل‌ها ۱۰۳
۱-۴-۳-۳) بررسی اثر تغییرات فلوی گاز نیتروژن بر روی ثابت هال و چگالی حامل‌ها در دمای اتاق ۱۰۳
۲-۴-۳-۳) بررسی اثر تغییرات فلوی گاز نیتروژن بر روی ثابت هال و چگالی حامل‌ها در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد ۱۰۳
۵-۳-۳) بررسی اثر تغییر دمای زیرلایه بر روی ثابت هال و چگالی حامل‌ها ۱۰۵

۱۰۶.....	بررسی اثر تغییر توان های تخلیه الکتریکی بر روی ضریب هال لایهها
۱۱۱.....	خلاصه نتایج
۱۱۴.....	پیشنهادات
۱۱۵.....	منابع

فهرست شکل‌ها

۱ فصل اول : بررسی منابع و پیشینه تحقیق

۲۱ شکل (۱-۱): رشد جزیره ای
۲۲ شکل (۲-۱): رشد لایه ای
۲۲ شکل (۱-۳): رشد جزیره ای - لایه ای
۳۵ شکل (۱-۴): سیستم کندوپاش دیودی
۳۶ شکل (۱-۵): سیستم کندوپاش تریودی
۳۸ شکل (۱-۶): سیستم کندوپاش مگنترونی

۲ فصل دوم : مواد و روشها

۴۶ شکل (۲-۱): سیستم کندوپاش مگنترونی
۴۸ شکل (۲-۲): انواع کاتدهای مورد استفاده در کندوپاش مگنترونی
۴۹ شکل (۲-۳): (الف). کندوپاش متوازن (ب). کندوپاش نامتوازن
۵۴ شکل (۴-۲): هدف کندوپاش مگنترونی
۵۵ شکل (۵-۲): لامپ‌های قلمی برای گرم کردن زیرلایه
۵۶ شکل (۶-۲): سیستم کندوپاش پلاسمایی مگنترونی دانشکده فیزیک
۶۴ شکل (۷-۲): پروف چهار سوزنی برای نمونه‌های حجمی
۶۵ شکل (۸-۲): پروف چهار سوزنی
۶۸ شکل (۹-۲): طرحواره‌ای از اثر هال
۶۹ شکل (۱۰-۲): لایه‌ی نازکی که یک جریان طولی از آن می‌گذرد.
۷۲ شکل (۱۱-۲): نمایی از دستگاه زمپا
۷۳ شکل (۱۲-۲): نحوه اتصال سیمها به لایه در داخل دستگاه زمپا

۳ فصل سوم : نتایج و بحث

۷۵ شکل (۱-۳): مشخصات ابعادی لایه‌های مورد استفاده در پروژه
----	---

- شکل (۲-۳) : طرحواره‌ای از دستگاه پروب چهار سوزنی مورد استفاده در پژوهش ۸۲
- شکل (۳-۳) : طیف XRD مربوط به لایه شماره ۳ که در دمای اتاق نهشت یافته‌اند. ۹۰
- شکل (۴-۳) : طیف XRD مربوط به لایه شماره ۱۲ که در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد نهشت یافته‌اند. ۹۱
- شکل (۵-۳) : نمایی از لایه، قبل از انجام عملیات کنتاکت زنی، که سیم‌ها بر روی آن بوسیله چسب GM محکم شده‌اند. ۹۹
- شکل (۶-۳) : نمایی از لایه، که در آن سیم‌ها بوسیله چسب نقره به لایه کنتاکت زده شده‌اند. ۱۰۰
- شکل (۷-۳) : طرحواره‌ای از نمونه با کنتاکت‌های آن ۱۰۱

فهرست جداول

۱ فصل اول : بررسی منابع و پیشینه تحقیق

۲ فصل دوم : مواد و روشها

۳ فصل سوم : نتایج و بحث

جدول (۱-۳) : نرخ لایه نشانی برای توانهای مختلف AC برای یک هدف آلومینیومی به ازای فلوهای مختلف گاز

نیتروژن ۷۶

جدول (۲-۳) : نرخ لایه نشانی برای توانهای مختلف DC برای یک هدف تیتانیومی به ازای فلوهای مختلف گاز

نیتروژن ۷۸

جدول (۳-۳) : مشخصات لایه‌های نهشت شده بر روی زیرلایه‌های کوارتزی در دمای اتاق ۸۰

جدول (۴-۳) : مشخصات لایه‌های نهشت شده بر روی زیرلایه‌های سرامیکی در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد .. ۸۱

جدول (۵-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه‌های ۱ و ۷ که در فلوهای مختلف

نیتروژن در دمای اتاق نهشت یافته اند..... ۸۳

جدول (۶-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه‌های ۲ و ۶ که در فلوهای مختلف

نیتروژن، در دمای اتاق نهشت یافته اند..... ۸۳

جدول (۷-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه‌های ۳ و ۵ که در فلوهای مختلف

نیتروژن، در دمای اتاق نهشت یافته اند..... ۸۴

جدول (۸-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه‌های ۴ و ۸ که در فلوهای مختلف

نیتروژن، در دمای اتاق نهشت یافته اند..... ۸۴

جدول (۹-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه‌های ۹ و ۱۳ که در فلوهای مختلف

نیتروژن، در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد نهشت یافته اند..... ۸۵

جدول (۱۰-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه‌های ۱۰ و ۱۴ که در فلوهای مختلف

نیتروژن، در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد نهشت یافته اند..... ۸۶

جدول (۱۱-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۱۱ و ۱۵ که در فلوهای مختلف نیتروژن، در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد نهشت یافته اند.....	۸۶
جدول (۱۲-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۱۲ و ۱۶ که در فلوهای مختلف نیتروژن، در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد نهشت یافته اند.....	۸۶
جدول (۱۳-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۱ و ۱۴ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۸۷
جدول (۱۴-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۲ و ۱۵ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۸۸
جدول (۱۵-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۳ و ۱۶ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۸۸
جدول (۱۶-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۴ و ۱۳ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۸۸
جدول (۱۷-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۵ و ۱۲ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۸۹
جدول (۱۸-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۶ و ۱۱ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۸۹
جدول (۱۹-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۷ و ۱۰ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۸۹
جدول (۲۰-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی نمونه های ۸ و ۹ که در دماهای مختلف زیر لایه نهشت یافته اند.....	۹۰
جدول (۲۱-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی لایه هایی که در دمای زیرلایه یکسان ولی در توانهای تخلیه الکتریکی مختلف نهشت یافته اند.....	۹۲
جدول (۲۲-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی لایه هایی که در دمای زیرلایه یکسان ولی در توانهای تخلیه الکتریکی مختلف نهشت یافته اند.....	۹۴

جدول (۲۳-۳) : مقایسه مقاومت الکتریکی، مقاومت ویژه و رسانندگی الکتریکی لایه هایی که در دمای زیرلایه یکسان ولی در توانهای تخلیه الکتریکی مختلف نهشت یافته اند.....	۹۶
جدول (۲۴-۳) : نتایج حاصل از اندازه گیری ثابت هال برای نمونه ها.....	۱۰۲
جدول (۲۵-۳) : مقایسه ثابت هال نمونه های ۹ و ۱۳ برای فلوهای مختلف گاز نیتروژن	۱۰۴
جدول (۲۶-۳) : مقایسه ثابت هال نمونه های ۱۰ و ۱۴ برای فلوهای مختلف گاز نیتروژن	۱۰۴
جدول (۲۷-۳) : مقایسه ثابت هال نمونه های ۱۱ و ۱۵ برای فلوهای مختلف گاز نیتروژن	۱۰۴
جدول (۲۸-۳) : مقایسه ثابت هال نمونه های ۶ و ۱۱ برای دماهای مختلف زیرلایه	۱۰۵
جدول (۲۹-۳) : مقایسه ثابت هال نمونه های ۷ و ۱۰ برای دماهای مختلف زیرلایه	۱۰۶
جدول (۳۰-۳) : مقایسه ثابت هال نمونه های ۵ تا ۸ با تغییر توان های تخلیه الکتریکی DC و AC	۱۰۷
جدول (۳۱-۳) : مقایسه ثابت هال نمونه های ۹ تا ۱۲ با تغییر توان های تخلیه الکتریکی DC و AC	۱۰۸

مقدمه

تکنولوژی فیلم‌های نازک بطور همزمان یکی از قدیمی‌ترین هنرها و در عین حال یکی از جدیدترین علوم به شمار می‌رود. مفید بودن خصوصیات لایه‌های نازک و جالب توجه بودن مطالعه بر روی رفتار جامدهای دو بعدی باعث شده که چه از نظر علمی و چه از نظر تکنولوژیکی به لایه‌های نازک توجه ویژه‌ای صورت گیرد و باعث پیشرفت سریع فناوری لایه‌های نازک، بویژه پیشرفت رونشانی در خلاً شود.

اولین لایه نازک در سال ۱۸۳۸ به روش الکترولیز تهیه شد. پس از آن در سال ۱۸۵۲ بانسن^۱ و گرو^۲ توانستند به ترتیب با استفاده از روش واکنش شیمیایی و کندوپاش توسط تخلیه نورانی، لایه‌های نازکی از فلزات را تهیه کنند. بعدها فارادی در سال ۱۸۵۸ با عبور دادن جریان الکتریکی زیاد از یک سیم فلزی و تبخیر آن (سیم انفجاری^۳) توانست لایه‌های نازک فلزی بدست آورد. لایه‌های نازک خواص اپتیکی، الکتریکی، مکانیکی و خواص قابل ملاحظه دیگری را از خود نشان می‌دهند. علاوه بر آن، ممکن است لایه‌های نازک، روی فرایندهای مختلفی که در سطح و فصل مشترک روی می‌دهد مانند خوردگی، اصطکاک و غیره اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشند.

لایه‌های نازک با توجه به خواصشان کاربردهای متنوعی دارند. یکی از کاربردهای مهم لایه‌های نازک کاربردهای اپتیکی از جمله استفاده بعنوان پوشش‌های بازتابی یا چند بازتابی و همچنین کاربرد در حافظه‌های اپتیکی در فناوری ذخیره اطلاعات است. لایه‌های نازک در چند سال گذشته در الکترونیک کاربردهای زیادی پیدا کرده است. تکنولوژی لایه‌های نازک در ساخت اتصالات الکترونیکی، اتصال‌های بیانابینی، مقاومت‌ها، خازن‌ها و القاگرهای قطعات الکترونیکی فعال (دیودها و ترانزیستورها) مدارهای

¹. Bunson

². Grove

³.Exploding Wire

یکپارچه (*IC*), لایه‌های فرومغناطیس و ابررسانا و... کاربرد وسیعی دارد [۲ و ۱].

در فصل اول این پژوهش لایه‌های نازک، خواص آنها و روش‌های تهیه لایه‌های نازک معرفی خواهد

شد.

در فصل دوم، از روش‌های تهیه لایه‌های نازک، روش کندوپاش مگنترونی به طور کامل توضیح داده

شده و دستگاه کندوپاش مگنترونی موجود در دانشکده فیزیک دانشگاه تبریز معرفی شده است. در ادامه

فصل نیز به خواص الکتریکی لایه‌های نازک و روش‌های اندازه گیری این خواص برای لایه‌های نازک اشاره

شده است.

در نهایت در فصل سوم، نتایج بدست آمده از اندازه گیری خواص الکتریکی لایه‌های نازک

نانوساختار آلومینیوم تیتانیوم نیترید، ارائه شده و همچنین تأثیر تغییر شرایط نهشت بر روی خواص

الکتریکی لایه‌ها، در قالب جداول و نمودارها، بررسی شده است.

فصل اول

بررسی منابع و ریشه نجفیو

۱ فصل اول

۱-۱) مقدمه

در سال‌های اخیر، علم لایه‌های نازک در میان سایر علوم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بی‌شک رشد چشمگیر ارتباطات، پردازش اطلاعات، ذخیره سازی، صفحه‌های نمایش، صنایع تزئینی، ابزارآلات نوری، مواد سخت و عایق‌ها، نتیجه‌ی تولید لایه‌های نازک براساس فناوری‌های نوین می‌باشد. در ساخت لایه‌های نازک نیز در سال‌های اخیر تحولات وسیعی صورت گرفته است که خود ناشی از پیشرفت در فناوری خلاء، تولید میکروسکوپ‌های الکترونی و ساخت وسایل دقیق و پیچیده شناسایی مواد است. همچنین باز شدن مباحثی نظیر میکروالکترونیک، اپتیک و نانوتکنولوژی مدیون اهمیت پوشش‌های لایه نازک می‌باشد. از نقطه نظر تاریخی در ابتدا از تکنولوژی لایه نازک در صنایع مدارهای مجتمع استفاده شد. در ادامه، طی ۴۰ سال اخیر، نیاز صنایع به ابزارهای کوچکتر و سریعتر، تکنولوژی و فیزیک لایه‌های نازک را جهت رسیدن به این هدف بهبود بخشد.

لایه‌های نازک، با ضخامت زیر میکرونی، با خواصی ناشی از دو ویژگی اصلی آنها که شامل نازک بودن و بزرگی فوق العاده نسبت سطح به حجم است، کاربردهای فراوانی در فناوری‌های نوین یافته‌اند. با توجه به عملکرد و خواص لایه‌های نازک، می‌توان از آنها جهت بهبود تکنولوژی‌هایی نظیر سلولهای خورشیدی، سنسورها، کاربردهای نوری، مهندسی الکترونیک نیز استفاده نمود[۳].

۲-۱) تعریف لایه نازک

به طور کلی لایه به ماده یا موادی گفته می‌شود که به صورت پوششی بر یک سطح یا ماده می‌نشینند و باعث ایجاد خواص فیزیکی جدیدی می‌شود که خصوصیات سطحی زیرلایه را ارتقاء می‌بخشد. معمولاً اگر لایه

تشکیل شده، نازک باشد، خواص فیزیکی جدیدی از خود بروز می‌دهد، که با خواص همان لایه به صورت توده-ای، متفاوت است زیرا در یک لایه نازک :

الف) ضخامت خیلی کم است.

ب) نسبت سطح به حجم آن خیلی زیاد است.

ج) دارای ساختار فیزیکی ویژه‌ای است که مستقیماً مربوط به فرایند رشد لایه می‌باشد.

بعضی از پدیده‌هایی که مربوط به ضخامت کم لایه‌های نازک می‌شوند عبارتند از :

تداخل نوری، تونل زنی الکترونی در لایه‌های عایق، مقاومت ویژه بالا و پایین بودن ضریب مقاومت حرارتی، بالا بودن نسبت سطح به حجم لایه‌های نازک مربوط به ضخامت کم آنهاست و نیز ریزساختارهای آنها پدیده‌های دیگری را از قبیل جذب سطحی گازها، پخش و غیره ایجاد می‌کند [۴، ۳ و ۵].

۳-۱) تقسیم بندی انواع لایه‌ها

تقسیم بندی انواع لایه‌ها را بر اساس رسانایی و ضخامت آنها انجام می‌دهند. بر حسب رسانایی، لایه‌ها را به سه دسته رسانا، نیم رسانا و عایق (نارسانا) تقسیم می‌کنند. لایه‌های رسانا، لایه‌هایی هستند که در آنها نوار رسانش نیمه پر است و یا نوار رسانش و نوار ظرفیت با هم همپوشانی می‌کنند. به همین دلیل در مورد اخیر نوار رسانش این لایه‌ها سرشار از الکترون‌های آزاد است. از جمله کاربردهای لایه‌های رسانا می‌توان به استفاده از آنها در ساخت مقاومت‌ها، اتصال‌های الکتریکی و همچنین قطعات الکترونیکی در مدارهای الکترونیکی اشاره کرد. اما لایه‌های عایق یا نارسانا، لایه‌هایی هستند که در آنها بین نوارهای ظرفیت و رسانش، یک گاف انرژی از مرتبه بین 5 eV تا 10 eV وجود دارد. از جمله کاربردهای این نوع لایه‌ها، می‌توان به ساخت مواد و لایه‌های عایق از آنها و همچنین کاربرد آنها در جداسازی فلزات از هم یا جدا کردن فلزات از نیمه‌رساناهای که در مدارات و قطعات الکترونیکی بسیار دیده می‌شود، اشاره کرد. اما

لایه‌های نیم رسانا، لایه‌هایی هستند که گاف انرژی آنها در بازه 5 eV تا 1 eV است و به همین دلیل دارای بیشترین کاربردها در صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک و در ساخت قطعات مختلف می‌باشند[۴].

از نقطه نظر ضخامت نیز اصولاً لایه‌ها و پوشش‌های مختلف به سه گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

- ۱- لایه‌های بسیار نازک با ضخامت کمتر از 50 آنگستروم
- ۲- لایه‌های نازک با ضخامت بین 50 تا 5000 آنگستروم
- ۳- لایه‌های ضخیم با ضخامت بیش از 5000 آنگستروم

طبق تعریف بالا، لایه‌های نازک، لایه‌هایی هستند که ضخامت آنها بین 50 تا 5000 آنگستروم می‌باشد.

لایه‌های نازک را می‌توان در دسته پوشش‌های نانوساختار دسته بندی کرد[۶].

۴-۱) خواص لایه‌های نازک

لایه‌های نازک، خواص بسیار جالبی دارند که متفاوت از خواص توده‌ای مواد تشکیل دهنده آنها است. این خواص شامل خواص الکتریکی، خواص مغناطیسی، خواص نوری، خواص مکانیکی، خواص شیمیایی و خواص حرارتی لایه‌های نازک می‌باشد. این خواص، به پارامترهای زیادی وابسته‌اند که این پارامترها مربوط به روش تولید و کیفیت و نوع ماده‌ی زیر لایه، خواهند بود. در مورد روش‌های لایه نشانی از پارامترهای مربوط به روش تولید، می‌توان به میزان خلا، جریان گاز عبوری حین فرایند رشد لایه، سرعت لایه نشانی و خلوص مواد پوشش، اشاره کرد[۷].

۴-۱) خواص مکانیکی

یکی از خواص مهم لایه‌های نازک خواص مکانیکی است. روش‌های مختلف تولید و ساخت لایه-